## Einsatzmöglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken



Ausgabe: 1 Wirksam ab: 01.08.2023 Seite 1 von 1

	Einbauweise		Fig	enschaf	ft der (	Grundwa	asserd	eckschic	ht	
	244.0000	außerhalb von Wasserschutzbereichen			ft der Grundwasserdeckschicht  innerhalb von Wasserschutzbereichen					
		ungünstig günstig		günstig						
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	WS	G III A	WSG III B		Wasservorrang-	
					HSG III		HSG IV		gebiete	
					Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton
		1	2	3		4		5		6
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel <sup>6)</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	-	+	-	+	+	+
14	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	+	-	+	+	+
15	Bauweisen 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	-	+	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	+	-	+	+	+

- 1) Die Verfüllung von Leitungsgräben ist nicht zulässig.
- 2) Zulässig, wenn Chrom, ges.  $\leq$  280  $\mu$ g/l, Vanadium  $\leq$  450  $\mu$ g/l, Kupfer  $\leq$  170  $\mu$ g/l und PAK15  $\leq$  3,8  $\mu$ g/l.
- 3) Zulässig, wenn Chrom, ges.  $\leq$  360 µg/l und Vanadium  $\leq$  180 µg/l.
- 4) Zulässig, wenn Vanadium ≤ 320 μg/l (Zeile 16) oder zulässig wenn "M" und Vanadium ≤ 200 μg/l (Zeile 17).
- 5) Zulässig bei Ausbildung der Bodenabdeckung als Dränschicht (Kapillarsperreneffekt)